X線CTを用いた電子デバイスの故障部位特定および原因解析

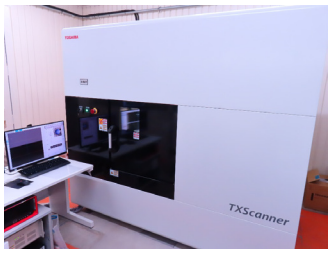
内部構造を壊さず、異常箇所の特定・原因解析を支援いたします。

概要

マイクロフォーカス/ナノフォーカスX線CTスキャン装置を活用し、電子デバイスや各種部品の内部構造を非破壊で観察・解析いたします。
さらに、非破壊観察で確認された異常箇所に対し、分析および他検査を組み合わせることで、原因究明まで一貫して対応いたします。

装置仕様

装置仕様	マイクロフォーカス	ナノフォーカス
最大管電圧（kV）	～300	～160
最大分解能（μm）	5	0.4
サンプルサイズ（mm）	φ420×600	φ300×20
サンプル重量（kg）	20	10



TOSHIBA製　TXScanner
（マイクロフォーカス）



SIGRAY製　Apex-Hybrid
（ナノフォーカス）

用途および主な特長

開発評価から市場不具合品解析、広視野観察から市場不具合品解析までワンストップでご提供いたします。

マイクロフォーカス → ナノフォーカス → 直接観察

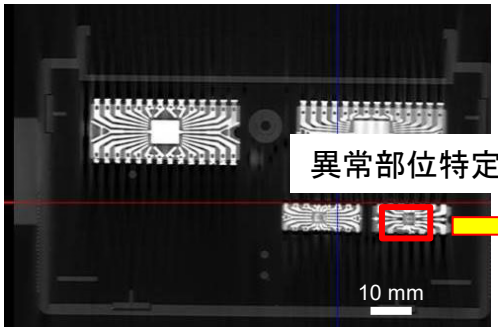
異常部位特定

原因部位の詳細観察

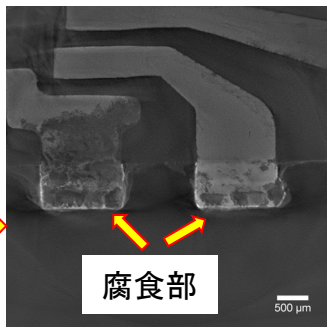
切出し後、SEM、元素分析などによる詳細調査

測定事例

不具合事例	観察可否
断線	○
ボイド	○
クラック	○
はんだ不良	○
ワイヤボンド不良	○
異物混入	○



マイクロフォーカスを用いた全体観察



ナノフォーカスを用いた詳細観察

※ お問い合わせ

製品に関する詳細や測定のご依頼は、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

JFE テクノリサーチ 株式会社
https://www.jfe-tec.co.jp
0120-643-777

Copyright ©2026 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。

Cat.No　3D6J-066-00-260825